附件1

2024中关村论坛展览（科博会）

参展项目申报信息

**企业全称**

**项目名称**

**项目介绍（200字左右）**

**展陈方案（如有实物展品请标明重量、规格）**

**媒体宣传亮点**

**以下参展项目申报信息模板，仅供参考。（企业填报完成后请删除红色字体部分）**

**（一）企业全称：**北京中科航发科技发展有限公司

**项目名称：**微纳级半导体光电特性三维检测系统

**项目介绍：**

技术亮点：1.高精度陶瓷金属特种焊接技术；2.运动控制系统：四轴高精度运动平台，采用自主生产的高精度导轨和电机，实现微米级定位；3.温度控制系统：采用国产压缩机制冷，分布式加热模块加热，实现大范围的精准温度控制；4.晶圆卡盘：卡盘采用陶瓷金属一体化特种焊接技术，极大降低卡盘漏电流。

国际先进性：1.技术指标达到国际先进水平，X-Y方向移动范围达到XX、位移精度小于等于XX、Z方向移动范围XX、温度范围XX、漏电流XX；2.核心部件完全自主可控：国产化率100%；3.与同类产品对比具备显著的价格优势。

获奖情况：1.进入国家重大科学仪器开发专项成果目录。2.获xxx奖项。

**展陈方式：**微纳级半导体光电特性三维检测系统，微纳级半导体光电特性检测台实物。

**媒体宣传亮点：xxxxxx（必填）**